

描述:

Tacusil SIA0210 是双组份有机硅灌封胶。它是透明的，在固化过程中和 HTHM 测试过程中具有较长的伸长率、较低的硬度和应力。Tacusil SIA0210 可以返修，且易剥离、无残留物，特别适用于光纤设备组装应用。

特性和优势:

- ❖ 透明
- ❖ 伸长率长
- ❖ 可返修

典型特性:

以下所有数据均在 25°C 条件下测定。

特性:	值:	测试方法或来源:
颜色	透明	视觉可见
配合比	A 组份比 B 组份	计算
按重量计	10:1	
按体积计	10:1	
完全固化时间	室温下为 24 小时	
粘度 - A 组份	6500 cps @ 1/s	平行平板式流变仪 25mm@1/s
粘度 - B 组份	100 cps @ 1/s	
粘度 - 混合后	2000 cps @ 1/s	
比重 - 混合后	1.12	计算
适用期 (定义为初始混合粘度翻倍所需的时间)	40 分钟	平行平板式流变仪 25mm@1/s
凝胶时间	90 分钟/10cc 样品	Sunshine 凝胶时间测定仪
硬度	25 邵氏 A	ASTM D2240
吸水率	24 小时后为 0.1%	ASTM D570
拉伸性能:		ASTM D638/MTS
强度	100 psi	
伸长率	400%	
模量	0.2Mpa	ASTMD 638
体积电阻率	6.18×10^{15} ohm-cm	ASTM D257
介电强度	410 V/mil	ASTM D149 方法 A

TACUSIL 对其产品的适销性、适用性或其它方面不作任何明示或默示的保证。此外，虽然此处所含的信息被认为是可靠的，但对于数据的准确性或从使用数据中获得的结果不作任何明示或暗示的保证。由于使用条件超出我们的控制范围，所以对所有的使用建议均不作保证。所给的属性是典型值，不用于准备规范。用户应自行进行测试，以确定本产品是否适合自己的目的。

体电阻率	2*10E15 ohm-cm	Jandel 四探针测试仪
非挥发物含量*	99.9 %	
TMA 测量的热膨胀系数	200 ppm/°C	ASTM E831
使用温度**	-50~180°C	
透射比	96% @ 6mm	ASTM D1003, 规程 A

* 星号表示认为是相关树脂系统的典型值或从其它测试结果推断出来的值。

** 温度额定值是基于平均设计要求，不作为在该温度下工作的所有应用的适用性的保证。

*** 本 TDS 含有已更新的值。本技术数据表中报告的值是产品的典型值，很大程度上取决于测试条件和方法。我们积极寻求最精确、最准确的方法来测量和诠释我们的产品性能，并用测量值更新估计值。配方未作任何修改或更改。虽然书面上的值已改变，但预期产品的性能相同。

指南：

1. 用 MEK、IPA 或其它有机溶剂擦去基材上的粉尘、油污和其它杂质，以确保粘合剂对基材的附着力。
2. 接触强酸和氧化剂会降低其固化速度，延长固化时间。
3. 混合前，把两个组份都放在室温下。虽然 A 组份里没有填料，但仍有必要在使用前将其搅拌至均匀，并把 A 和 B 部分精准、彻底地混合，不时刮擦容器侧面。不要从混合容器中倒出。转移到新容器中，因为残留的未混合材料可能会在铸件表面形成粘性斑点。在点胶过程中保持足够的速度以确保完全混合。
4. 在不受干扰的情况下固化，直到产品完全凝胶或触摸时无粘性。
5. 用适当的有机溶剂（如 MEK、丙酮或其它有机溶剂）清洗未固化的树脂。

保质期和存储：

在 25°C 下的保质期为 12 个月
特殊包装的保质期可能更短。

有机硅

加成型固化有机硅含有一种易受抑制的催化剂。常见的抑制源包括：胺或含胺化合物、硫或含硫化合物、有机锡催化剂或含有有机锡催化剂的塑料、不饱和烃类增塑剂和焊剂残留物。在疑似抑制源部位有未固化或部分固化的产品表明不相容。

TACUSIL 对其产品的适销性、适用性或其它方面不作任何明示或默示的保证。此外，虽然此处所含的信息被认为是可靠的，但对于数据的准确性或从使用数据中获得的结果不作任何明示或暗示的保证。由于使用条件超出我们的控制范围，所以对所有的使用建议均不作保证。所给的属性是典型值，不用于准备规范。用户应自行进行测试，以确定本产品是否适合自己的目的。